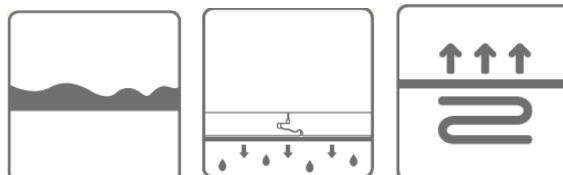


**Quick-Step® BASIC PLUS**

**QSUDLBP15**  
**QSUDLBP60**



*Parquet* LAMINATE



**Opis produktu: Szukam rozwiązania, które będzie przyjazne dla mojego budżetu**


Przed położeniem podłogi Quick-Step® należy zamontować podkład. Dobry podkład stanowi stabilne podłoże, na którym opiera się wysokiej jakości podłoga, a jednocześnie izoluje pomieszczenia przed ciepłem oraz dźwiękiem dobiegającym z zewnątrz. Wszystkie podkłady Quick-Step:

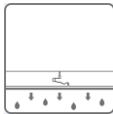
- wyrównują podłoże;
- chronią podłogę przed wilgocią od podłoża; a także
- mogą zostać wykorzystane z ogrzewaniem podłogowym.

Podkład Basic Plus ma 3-warstwową konstrukcję. Każda z warstw spełnia określone zadanie w celu maksymalizacji wygody korzystania z podłogi Quick-Step®. (warstwa ochronna, warstwa zapewniająca wygodę, warstwa wyrównująca).


	QSUDLBP15	QSUDLBP60
Opakowanie	1 rolka = 15 m <sup>2</sup>	1 rolka = 60 m <sup>2</sup>
Wymiary	15,96 m x 0,94 m	63,83 m x 0,94 m
Grubość	2 mm	2 mm
Waga (1 szt.)	1 810 kg	7 200 kg
Liczba na paletce	20 sztuk	6 sztuk
Wymiary palety (dł. x szer. x wys.)	1 200 x 800 x 1 150 mm	1 200 x 800 x 1 150 mm
Waga palety	44,6 kg	41,4 kg

	<h2>Idealne do zastosowania z podłogami Uniclic® oraz Uniclic® Multifit.</h2> <p>Gładka powierzchnia podkładów zapobiega dostawaniu się części podkładu pomiędzy pióro i wpust podczas montażu paneli. Dodatkowo wszystkie podkłady Quick•Step® stanowią stabilną bazę, która zapewnia ochronę systemu montażu paneli Uniclic®.</p>
	<h3>Dudnienie = Odgłos odbicia</h3> <p>Dźwięk, który można usłyszeć w trakcie przechodzenia po podłodze.</p>
Wynik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wynik:</b> **</li> <li>• <b>Norma:</b> Norma wewnętrzna</li> <li>• <b>Instytut:</b> Badanie wewnętrzne</li> </ul>
Metoda przeprowadzenia testów	<p>Nie istnieje żadna oficjalna metoda badania tego rodzaju izolacji akustycznej, dlatego wielu producentów stosuje w tym celu własne metody przeprowadzania badań. Spółka Unilin wykorzystuje oznaczenia gwiazdkami w celu zaprezentowania względnej różnicy pomiędzy różnymi podkładami Quick-Step®. Warto wspomnieć w tym miejscu, że gwarantujemy niezmienną redukcję dźwięku przez cały okres użytkowania produktu.</p>
Dlaczego to jest ważne?	<p>W pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu dźwięk butów uderzających o podłogę może być postrzegany przez niektóre osoby za niezwykle irytujący. Warstwa zapewniająca wygodę podkładu Basic Plus została zbudowana z pianki poliolefinowej o specjalnej zamkniętej strukturze komórkowej opracowanej specjalnie z myślą o podłogach Quick-Step®. Po ściśnięciu, warstwa ta zawsze powraca do stanu pierwotnego, co zapewnia optymalny kontakt z podłogą laminowaną i zapobiega uciążliwemu dudnieniu.</p>

	<h3>Odgłos uderzeń</h3> <p>Fale dźwiękowe przechodzące przez podłogę, które mogą być uznane za irytujące przez sąsiadów.</p>
Rezultat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><math>\Delta L_w</math> (dB): 18-19 dB</b></li> <li>• <b>Norma:</b> ISO 140-8.</li> <li>• <b>Instytut:</b> FCBA</li> </ul>
Metoda przeprowadzenia testów	<p>Odgłos uderzeń jest określany w postaci <math>\Delta L_w</math>. Wynik ten mierzony jest zgodnie z protokołem określonym w normie ISO 140-08 i przedstawia ważoną wartość obniżenia ciśnienia akustycznego uderzenia.</p>
Dlaczego to jest ważne?	<p>Odgłosy uderzeń mogą być odczuwane jako bardzo irytujące przez sąsiadów. W niektórych krajach przepisy budowlane określają minimalne wartości redukcji odgłosów uderzeń w budynkach mieszkalnych. Struktura plastra miodu redukuje fale dźwiękowe pod podłogą, które mogą być uciążliwe dla sąsiadów mieszkających poniżej.</p>

	<h3>Odporność na wilgoć</h3> <p>ochrona przed wilgocią od podłoża.</p>
Rezultat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wynik:</b> Wartość <math>S_d &gt; 100</math> m</li> <li>• <b>Norma:</b> EN 12086</li> </ul>
Metoda przeprowadzenia testów	<p>Odporność podkładu na wilgoć jest mierzona zgodnie z Metodą A opisaną w normie EN 12086.</p>
Dlaczego to jest ważne?	<p>Zaleca się montaż podkładu z wbudowaną barierą paroizolacyjną w celu ochrony podłogi przed wilgocią od podłoża. Aby zapewnić pełną odporność na wilgoć, należy uszczelnić wszystkie miejsca łączenia przy pomocy taśmy zabezpieczającej przed wilgocią. Podkład Quick•Step® Basic Plus został wyposażony w zintegrowaną barierę paroizolacyjną, co</p>

	oznacza, że nie jest konieczne instalowanie oddzielnej warstwy folii paroizolacyjnej. Podkład jest wyposażony w elementy i paski klejące umożliwiające szybki i prosty montaż.
--	--

	<b>Rezystancja termiczna</b> Podkład może być stosowany z ogrzewaniem podłogowym
Wynik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wynik:</b> R: 0,066 m<sup>2</sup>K/W.</li> <li>• <b>Norma:</b> EN 12664</li> <li>• <b>Instytut:</b> Badanie wewnętrzne</li> </ul>
Dlaczego to jest ważne?	Rezystancja termiczna podkładu określa wartość różnicy temperatur w przypadku przenikania ciepła przez dany materiał. Wynik ten określa się poprzez podzielenie grubości produktu przez jego przewodność cieplną, a jednostką miary jest wat na metr-kelwin. W zależności od preferencji klienta, wartość ta musi być wysoka lub niska. W przypadku stosowania produktu z ogrzewaniem podłogowym należy zadbać o niską wartość rezystancji termicznej, natomiast w przypadku chęci zaizolowania podłogi należy zastosować podkład o wysokiej rezystancji. Przy ocenie rezystancji termicznej należy dodać wartości rezystancji całej posadzki (podłogi oraz podkładu). W przypadku zastosowania podkładu z systemami ogrzewania podłogowego wartość ta nie może przekraczać 0,15 m <sup>2</sup> K/W, natomiast w przypadku systemów chłodzenia podłogowego nie może być wyższa niż 0,10 m <sup>2</sup> K/W.

QSUDLBP15/60		Min. EPLF	Zal. EPLF
<b>PC (CEN/TS 16354)</b>	1,4 mm	> 0,5 mm	
<b>CS (CEN/TS 16534)</b>	27 kPa	> 10 kPa	> 60 kPa
<b>CC (CEN/TS 16534)</b>	2 kPa	> 2 kPa	> 20 kPa
<b>DL25 (CEN/TS 16534)</b>	> 10 000	> 10 000	> 100 000
<b>RLB (CEN/TS 16534)</b>	140 cm	> 50 cm	> 120 cm
<b>SD (CEN/TS 16534)</b>	> 100 m	> 75 m	
<b>IS (CEN/TS 16534)</b>	18 dB	> 14 dB	> 18 dB
<b>RWS (EN 16354:2018)</b>	93,5 Sone	TBC	TBC
<b>R (CEN/TS 16534)</b>	0,066 m <sup>2</sup> K/W	> 0,15m <sup>2</sup> K/W	

### Instrukcje

- Rozwinąć podkład tak, by logo Quick×Step® było skierowane do podłoża, a srebrna membrana chroniąca przed wilgocią znajdowała się na górze. Rolka jest zwinięta we właściwym kierunku.
- Układać fragmenty podkładu równolegle do kierunku układania podłogi Quick×Step®.
- Ułożyć pierwszy rząd podkładu zapewniając zakładkę o szerokości 2 cm/0,787 cala przy ścianie (pomijając nachodzenie na siebie taśmy i łączenia).
- Ułożyć następny rząd z zakładką przy poprzedzającym rzędzie. Usunąć pasek osłaniający klej na pierwszym rzędzie podkładu i przykleić zakładkę drugiego rzędu na kleju.
- Upewnić się, że podkład ściśle do siebie przylega oraz że zakładka została przyklejona prawidłowo na całej długości.
- Układać całą podłogę zgodnie z przedstawioną metodą.
- Ostatni rząd podkładu ułożyć zapewniając zakładkę o szerokości 2 cm/0,787 cala przy ścianie.
- Połączyć krótkie boki przy pomocy wodoodpornej taśmy.

Zastosowanie produktów innych producentów niż Quick•Step® może być przyczyną uszkodzenia podłogi Quick•Step®. Spowoduje to unieważnienie gwarancji udzielonej przez firmę Quick•Step®. Z tego względu stanowczo zalecamy stosowanie wyłącznie akcesoriów Quick•Step®, które zostały specjalnie opracowane i przetestowane z myślą o stosowaniu z panelami podłogowymi Quick•Step®.



Quick-Step® Basic Plus to wysokiej jakości produkt dystrybuowany przez spółkę U  
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke. **Telefon** +32 56 67 52 11. **Faks** +32 56

